



CAD/CAM用高透光性セミシタージェルコニアディスク

松風ディスク ZR ルーセント スープラ サービカル+

▲ S-WAVE

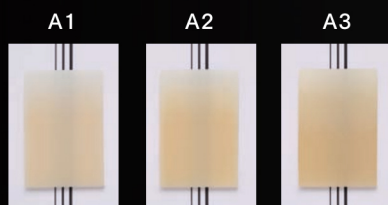


スープラに**新**シリーズ！

サービカル+

サービカル層をプラス！

ご好評いただいておりますスープラに新シリーズが登場！
サービカル層の比率を拡大したサービカル+。30mmの
ディスク厚によって高さのあるインプラントの上部構造にも
対応。歯内部を3Yの強度で支えるため、咬合圧による破
損のリスクを軽減します。



※ 印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

SHOFU DISK ZR
Lucent
Supra
Cervical+

SHOFU INC.

スーブラのトリプルグラデーション技術を継承

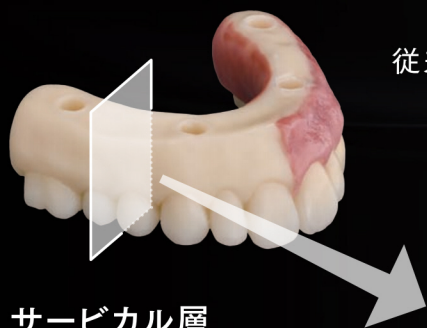
従来品「松風ディスク ZR ルーセント スーブラ」の松風独自のトリプルグラデーション技術を継承し、

『強度』×『透光性』×『色調』を機能的にディスク内に配置しています。



従来品に比べ、**サービカル層を厚く**設計しており

高さのある補綴装置の加工に適しています！



サービカル層

歯頸部の遮蔽性向上と、ロングスパンブリッジにも対応可能な高い強度

ボディー層

層の界面が識別されにくい、すぐれたグラデーション機能

エナメル層

前歯部にも対応可能な高い透光性

	ディスク層	3点曲げ強さ ※1 (代表値)	可視光透過率 ※2 (代表値)
サービカル層	65.3%	1454 MPa	37%
ボディー層		1163 MPa	40%
エナメル層	16.0%	1034 MPa	44%

※1 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる) ※2 可視光透過率 (JIS R 3106:2019に準ずる、色調:A2、試験体厚さ:0.5mm)

■ 推奨焼結スケジュール メタコネクターを使用する場合には、加工物を縦置きにして焼結してください。

	昇温速度	焼結温度・係留時間	降温速度	総焼結時間
焼結スケジュール 1 (標準)	室温～1450℃ …… 5℃/分～10℃/分	1450℃・120分	炉内放冷又は5℃/分～10℃/分にて降温	約8.7時間 ※3
焼結スケジュール 2 (短時間)	①室温～1000℃ …… 60℃/分 ②1000℃～1450℃ …… 10℃/分	1450℃・90分	①1450℃～1000℃ …… 40℃/分 ②1000℃～250℃ …… 60℃/分	約2.9時間 ※4

※3 室温(30℃)～1450℃:5℃/分昇温、1450℃120分係留、1450℃～250℃:10℃/分降温の場合。

※4 「オストロマット 674i」を用いて降温プログラムを使用した場合。

焼結スケジュール2を

ご使用される際の注意点

- ・焼結スケジュール1と2では、焼結後の色調に差が出る場合があります。
- ・2段で焼結すると焼結台が割れる可能性があるため、必ず1段で焼結してください。
- ・焼結スケジュール 2の適応症例は単冠～3歯ブリッジまでです。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スーブラ サービカル+	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A06

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の価格は2024年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

包装・価格

松風ディスク ZR ルーセント スーブラ サービカル+

30mm……………¥68,000

【サイズ】 1種類: φ98×30mm

【色 調】 3色: A1、A2、A3



取扱い店